

**「エスパネックス」の生産能力倍増と
営業体制の強化について**

当社（社長：西恒美）先端材事業部は、回路基板材料事業の主力商品であるフレキシブルプリント基板用無接着剤銅張積層板（2層CCCL）「商品名：エスパネックス」につきまして、現在、来年春を目処に300万㎡/年へと能力増強中ですが、今回、さらに約25億円を投資して平成15年秋までに生産能力を現在の約2倍強となる400万㎡/年へ増強することを決定いたしました。

【生産能力増強について】

最新型携帯電話用のヒンジ（折り曲げ）部および液晶画面の駆動IC向けを中心とする需要の急伸にともない、今年春以来フル生産が続いており、今後もさらに需要の伸びが見込まれることから、現在180万㎡/年の生産能力を硬化工程、検査工程など後工程の増強により、来年春には300万㎡/年へと段階的に引き上げるとともに、現在、製造を行っている木更津製造所（千葉県木更津市）内に製造ラインを新設し、平成15年秋には400万㎡/年といたします。また、今後の需要動向によって、500万㎡/年までの増強を計画しています。

【2層CCCLの市場動向について】

ここ数年2層CCCLは、携帯電話を中心とするデジタル機器の小型軽量化、高性能化に伴う回路基板の高密度実装化、微細加工化に不可欠な材料として、需要が拡大を続けております。特に今年春から携帯電話用途を中心に「エスパネックス」に対する需要が急速に増加しており、今年6月には、木更津製造所内に新たに導入した設備の商業運転を開始いたしました。フル生産が続いており、需要の一部対応出来ない状況となっております。

【「エスパネックス」の需要動向について】

当社の2層CCCL「エスパネックス」は、デジタル機器の小型軽量化、高性能化に伴う回路基板の高密度実装、微細加工に必要な「寸法安定性」「銅箔接着力の信頼性」「絶縁性」「回路加工性」に優れております。特に、最近の携帯電話で主流となっている折り畳み式携帯電話端末のヒンジ（折り曲げ）部に要求される「耐屈曲性」にも優れ、2層CCCLの分野では、事実上の標準材料となっております。現在需要を牽引している国内カラ・携帯電話端末向けの「ヒンジ+多層一体型基板」や「液晶画面駆動IC」をはじめ、韓国、欧州におけるカラ・携帯電話端末の本格普及に伴い、継続的な需要の拡大が見込まれております。

また「エスパネックス」は、パソコン用液晶画面、液晶テレビ、プラズマディスプレイ、有機ELといったフラットパネルディスプレイ向けや、デジタルカメラ、DVDなど、携帯電話以外にも用途が着実に拡大しており、今後さらに需要の伸長に拍車がかかるものと予測しております。

【企画・営業・開発体制の強化について】

いっそうの事業基盤の拡充を目的に、11月1日より先端材事業部の組織を以下のとおり強化することといたしました。

急速な事業規模の拡大に対応するため「企画管理部」を設置する。

回路基板材料（エスパネックス）と半導体実装材料（エスアレックス）の販売機能を強化するため、両ビジネスユニットを統合し「回路基板・実装材料部」を設置する。

研究開発については、電子材料研究所を会社直轄の組織とし、事業部支援を行いつつ、中長期的な視点からの新商品・新プロセス開発力の充実・強化を図る。

以上の、新たな組織体制のもとで、エスパネックスについては、600万㎡/年～800万㎡/年への増強を視野に入れた検討を進めるとともに、フラットパネルディスプレイ関連材料、半導体実装材料、新商品なども含め、3～5年後には先端材事業部トータルで約300億円の売上規模を目指していきます。

本件に関するお問い合わせは、
新日鐵化学株式会社
総務部（広報）

03 - 5759 - 2741まで